

公 募 案 内

令和6年4月25日

応募条件	募集職名	事務支援員 ・ 1名
	資格等条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O A 機器の基本操作とWord, Excel等で自ら文書・表作成等ができる方</li> <li>・ 明るく協調性があり, 健康で責任感のある方</li> <li>・ 学生との対応を円滑に行える方</li> <li>・ コミュニケーション能力が優れている方</li> <li>・ ウェブページの管理ができるとなお望ましい</li> </ul>
	業務内容	<p>学生支援センター未来人材育成部門（以下、「部門」）に関する以下の業務</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Word, Excel, PowerPointを使用しての資料・データ作成</li> <li>2. 会議・イベント等の運営業務（事前準備含む）</li> <li>3. 予算管理を含む経理業務全般</li> <li>4. 部門が管理する大型ディスプレイへの情報配信作業</li> <li>5. ウェブページの管理更新作業</li> <li>6. 部門の取組みに参加する学生への対応</li> <li>7. その他雑務（居室内の掃除、ゴミ捨て等）</li> </ol> <p>※業務内容・業務場所, 職名については, 今後, 組織の変更・業務分担の変更に伴い, 本学が定める範囲内において変更される可能性があります。                  ※詳細は, 下記担当までお問い合わせください。                  氏名: 学生支援課 岡村 Eメール: gak.sie@jim.titech.ac.jp                  T E L : 03-5734-3011 F A X : 03-5734-3240</p>
	勤務予定地	東京都目黒区大岡山2-12-1 学生支援センター未来人材育成部門
	応募書類	<p>履歴書（※<a href="#">使用推奨様式</a>有り・写真貼付・氏名は自署のこと・Eメールアドレス記載）                  職務経歴書（※任意・様式自由）</p> <p>* 応募書類は返却しません。                  * 本学での勤務経験がある場合は、所属していた部署名や従事していた研究室名まで詳しくご記入をお願いします。</p>
	応募方法	封筒に「学生支援センター（未来人材育成部門）事務支援員応募書類在中」と朱書し下記提出先宛に郵送, または持参
応募締切	令和6年5月31日（金）17時 必着	
採用試験	選考方法	第1次 : 書類選考 第2次 : 面接試験
	試験日	令和6年6月5日（水） * 応募締切後に選考を行い, 第1次試験合格者には, 前日までに時間・場所等を通知します
	内定通知	最終選考の後, 6月10日（月）までに通知
待遇及び労働条件	雇用期間	<p>令和6年7月1日 ~ 令和7年6月30日</p> <p>※更新の可能性有り（最長で 令和9年6月30日まで）                  ※雇用の更新は、更新の必要性、雇用経費及び更新前の勤務実態を総合的に勘案して決定                  ※2週間の試用期間有り 業務内容及び労働条件同じ                  ただし、本学有期雇用職員就業規則第7条,第12条による</p>
	給与	1. 時間給 1,390円（通勤手当※本学有期雇用職員就業規則第56条による）
	勤務時間等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1週間の通常勤務時間 週5日 30時間（休憩時間12:15~13:15） 月~金 : 8:30~ 15:30（6時間）（勤務時間は応相談）</li> <li>2. 超過勤務: 有（月平均7時間）</li> <li>3. 休日: 土曜, 日曜, 祝日, 年末年始（12/29~1/3）</li> <li>4. 有給休暇及びその他の休暇制度あり</li> </ol>
	宿舍	なし
	社会保険等	厚生年金, 共済（短期）, 雇用保険, 労働者災害補償保険
	雇用主	国立大学法人東京工業大学長
その他	<p>敷地内禁煙（ただし, 屋外指定箇所に喫煙所設置）                  令和6年秋を予定している東京医科歯科大学との統合により, 新大学においては労働条件</p>	

	変更の可能性があります。
応募書類提出先	〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 (TP-001) 国立大学法人東京工業大学学務部学生支援課支援企画グループ T e l : 03-5734-3011, Eメール : gak.sie@jim.titech.ac.jp